

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2024-025

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327551705 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同兴达	股票代码	002845
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李岑	宫兰芳	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 栋 16 楼证券部	深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 栋 16 楼证券部	
传真	0755-33687791	0755-33687791	
电话	0755-33687792	0755-33687792	
电子信箱	zqswdb@txdkj.com	zqswdb@txdkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事 LCD、OLED 显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、生产和销售，其

中显示模组主要产品包括智能手机类、平板及笔记本电脑类、智能穿戴类及专业显示类；光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板及笔记本电脑摄像头、智能产品类（智能手表、视讯通话等）摄像头、感知类（扫地机器人等）摄像头、识别类（智能门锁、人脸识别等）摄像头，上述产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、无人机、智能家居等领域。

显示模组主要应用场景如下：



智能手机

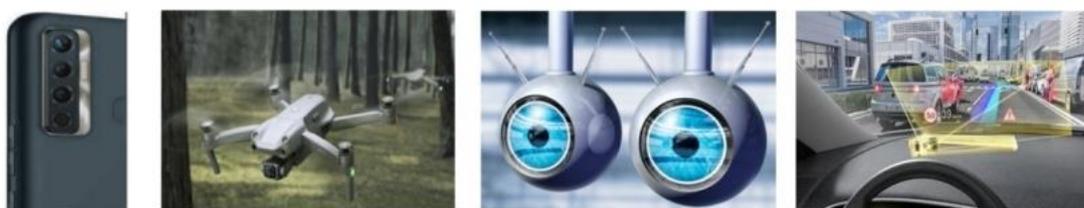
笔记本电脑

平板电脑

智能穿戴

专业显示

光学摄像头模组主要应用场景如下：



智能手机

无人机

生物识别

车载摄像

子公司赣州同兴达作为公司显示模组业务的载体，自 2017 年起不断投入优质资源，着力打造高端制造平台，现拥有智能手机类、智能穿戴类和平板电脑/笔记本电脑等一体化生产线 40 余条，已成为行业标杆智慧化工厂。

子公司南昌精密作为公司光学摄像头模组业务的载体，自 2017 年 9 月投产以来，凭借内部精细化管理及精益求精的质量要求，得到了下游优质大客户的认可，主流产品由目前 8M 至 104M 的手机类高像素产品逐步扩充到笔记本电脑、平板至工控、智能家居等更多领域。

子公司南昌同兴达汽车电子有限公司作为公司车载摄像头模组业务的载体，经过 2023 年紧张有序的筹备及客户拓展，与 Sony、博世、地平线、德赛西威、大疆车载、海康车载等国际知名厂商展开深度合作，取得多家供应商资质及定点开发项目，2024 年将相继进入量产阶段。

子公司日月同芯设立于 2021 年 12 月，主要从事半导体先进封测业务，投建全流程金凸块制造（GoldBumping）+晶圆测试（CP）+玻璃覆晶封装（COG）及薄膜覆晶封装（COF）（一期）等完整封测制程，建成月产能 2 万片 12 寸全流程 GoldBump（金凸块）生产工厂，主要应用于显示驱动 IC（含 DDIC 和 TDDI），具体业务如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成相关制程后的产品图示
Gold Bumping	金凸块制造是指通过溅镀、曝光、显影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的焊垫上制作金凸块，可达到高效的电性传输，替代了传统封装中的导线键合	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积，具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域，适用于覆晶封装（FC）技术	
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，在切割环节被淘汰，不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片，直接计算出良率，还可减少后续不必要的操作，有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序	

COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	是目前主流的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的金凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,330,361,892.95	7,345,031,124.09	13.41%	9,279,166,386.75
归属于上市公司股东的净资产	2,703,180,489.98	2,657,015,729.97	1.74%	2,765,895,146.75
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	8,514,028,612.44	8,418,763,622.18	1.13%	12,860,424,157.98
归属于上市公司股东的净利润	48,001,583.95	-40,180,716.05	219.46%	362,055,571.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,383,339.00	-217,133,522.01	109.85%	285,886,298.14
经营活动产生的现金流量净额	357,463,683.86	904,300,917.07	-60.47%	936,702,371.48
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.15	200.00%	1.55
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.15	200.00%	1.55
加权平均净资产收益率	1.79%	-1.46%	3.25%	14.24%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,590,493,552.72	2,070,748,551.48	2,375,317,067.88	2,477,469,440.36
归属于上市公司股东	-64,532,312.95	74,829,321.05	7,460,447.36	30,244,128.49

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,304,808.34	64,449,904.50	4,473,051.95	32,765,190.89
经营活动产生的现金流量净额	-437,653,109.36	585,383,579.91	-25,293,955.57	235,027,168.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万锋	境内自然人	17.04%	55,800,072	55,770,072	不适用	0	
钟小平	境内自然人	13.95%	45,700,800	45,700,000	不适用	0	
刘青科	境内自然人	6.00%	19,650,000	0	不适用	0	
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通民企高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.00%	19,650,000	0	不适用	0	
刘秋香	境内自然人	2.56%	8,376,800	0	不适用	0	
李锋	境内自然人	1.44%	4,732,800	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	4,564,073	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,086,969	0	不适用	0	
曾泓斌	境内自然人	0.59%	1,932,900	0	不适用	0	

#王栋	境内自然人	0.57%	1,869,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东万锋和李锋为夫妻关系，股东钟小平和刘秋香为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东王栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量 1,869,900 股，未通过普通证券账户持有本公司股票。				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

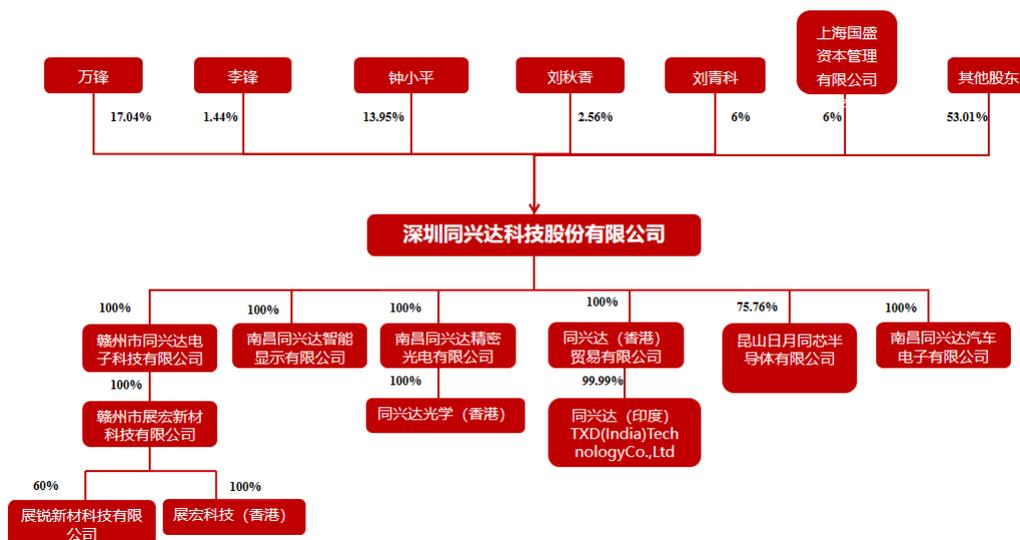
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘青科	新增	0	0.00%	19,650,000	6.00%
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通民企高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	19,650,000	6.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	4,564,073	1.39%
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,086,969	0.64%
王栋	新增	0	0.00%	1,869,900	0.57%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无